公司代码:603986　　公司简称:兆易创新

北京兆易创新科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示
1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3　公司全体董事出席董事会会议。
4　中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),预计派发现金红利总额为121,992,829.18元,占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的20.10%;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增128,413,504股,转增后公司股本变更为449,447,265股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本321,033,761股计算,实际派发现金红利总额、转入公积转增股本数量将以2019年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
二　公司基本情况
1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兆易创新	603986	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	王中华
办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层
电话	010-82263369	010-82263369
电子信箱	investor@gigadevice.com	investor@gigadevice.com

2　报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品及其用途
1.主营业务
公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售,其中传感器业务来自于2019年公司收购上海思立微电子科技有限公司(Silead Inc.)。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520),细分行业为闪存芯片、微控制器芯片及传感器芯片设计行业。公司产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以及通信设备、工业控制、汽车电子及工业控制设备等领域。
2.主要产品及用途
公司主要产品分为闪存芯片产品、微控制器产品以及2019年新增加的传感器产品。
公司闪存芯片产品主要为NOR Flash和NAND Flash两类。
1)NOR Flash闪代码型闪存芯片,主要用来存储代码及少量数据。公司NOR Flash产品广泛应用于PC主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、人工智能、物联网、穿戴式设备、医疗电子等。
2)NAND Flash闪数据型闪存芯片,分为两大类:大容量NAND Flash主要为MLC,TLC 2D NAND或3D NAND,擦写次数从几百次至数千次,多应用于大容量数据存储;小容量NAND Flash 主要是SLC 2D NAND,可靠性更高,擦写次数达到数万次以上。公司NAND Flash产品属于SLC NAND,广泛应用于网络设备、消费电子、智能电表、工业控制、汽车电子等。
公司微控制器产品(Micro Control Unit,简称MCU)主要为基于ARM Cortex-M系列芯位通用MCU产品,以及基于32位精简指令集的全球首颗基于RISC-V内核的32位通用MCU产品。GD32作为中国32位通用MCU领域的主流产品,以24个系列320余款产品选择,覆盖率稳居市场前列,产品广泛应用于工业和消费类嵌入式市场,适用于工业控制、人机界面、电机控制、智能家居家电及物联网等领域。
传感器主要产品包括电容触控芯片、指纹识别芯片,广泛应用于新一代智能移动终端的传感器模组,也适用于工业自动化、车载人机界面及物联网等需要智能人机交互解决方案的领域。
(二)经营模式
集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。从经营模式来看,主要分为IDM模式(企业业务覆盖集成电路的设计、制造、封装和测试的所有环节)和Fabless模式(无晶圆生产线集成电路设计模式,即企业只进行集成电路的设计和销售,将制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成)两种。公司作为芯片设计企业,自成立以来一直采取Fabless模式,专注于集成电路设计及最终销售环节,将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。
从集成电路整体产业链来看,集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节,成品销售则是控制销售渠道,客户资源及品牌的销售服务环节,这两个环节是产业链中具有较大及主导作用,是不设计生产的知识创新的体现和创造价值的源泉。公司专注于研发设计和产品销售环节,在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。
从销售模式看,公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下,公司与客户直接签署销售合同(订单)并发货;经销模式下,公司与经销商签署经销协议,由公司给经销商发货,再由经销商向终端客户销售,在此模式下,采取买断式销售。
(三)公司所属行业及核心竞争优势的行业地位分析
1.行业发展状况
集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期,正全力追赶世界先进水平,也正处于快速发展阶段,我国集成电路产业起步较晚,与国际大型同类公司对比较大差距,大量集成电路产品仍然需要通过进口解决。根据中国半导体行业协会统计,2019年1-6月中国集成电路产业销售额为5043.9亿元,同比增长13.2%。其中,设计业销售额为2122.8亿元,同比增长18.5%;制造业销售额为1320.6亿元,同比增长13.1%;封装测试业销售额为1600.6亿元,同比增长5.5%。根据中国半导体行业协会设计分会统计,2019年我国集成电路设计行业发展良好,销售总值保持增长,预计达到30843亿元,较2018年增长19.7%。根据中国海关统计数据,2019年中国集成电路进口金额3055.5亿美元,同比下降12.1%;集成电路进口数量4451.3亿个,同比增长6.6%。2019年中国集成电路出口金额1015.8亿美元,同比增长20.1%;集成电路出口数量2187亿个,同比增长50.7%。
集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。2018年3月,十三届全国人大一次会议政府工作报告中,集成电路被列入加快制造业创新升级的五大产业首位。根据《中国制造2025》规划目标,到2020年集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,主导产品满足国内主要需求,其中,设计业销售额年均复合增长率达到20%,封装测试业销售额达到65亿元,同比增长15%。根据中国半导体行业协会设计分会统计,2019年我国集成电路设计行业发展良好,销售总值保持增长,预计达到30843亿元,较2018年增长19.7%。根据中国海关统计数据,2019年中国集成电路进口金额3055.5亿美元,同比下降12.1%;集成电路进口数量4451.3亿个,同比增长6.6%。2019年中国集成电路出口金额1015.8亿美元,同比增长20.1%;集成电路出口数量2187亿个,同比增长50.7%。
2.公司产品部分领域情况
随着集成电路行业的快速发展,应用场景的不断扩展,以及新兴技术例如人工智能、物联网和虚拟现实的出现,集成电路产品的市场需求不断扩大。全球知名研究机构IHS Markit数据显示,2020年全球半导体市场预收收入将达到4,500亿美元,市场规模同比增长2%,其中主要的细分应用领域预计将实现较大的增长。Research 对2019第三季度存产品研究报告显示,公司Not Flash市场份额预计到13.3%,超越晋扬控股排名全球第二,前二名分别为华邦电子和旺宏电子,分别比HIS Market报告,在中国Arm Cortex-M MCU市场,2018年公司销售额排名为第三位,市场占有率14%,前两位分别为意法半导体(STMicroelectronics)和恩智浦半导体(NXP),依据赛迪数据,2018年公司传感器业务(思立微)中,触控芯片全球市场份额为11.40%,排名第四;指纹芯片全球市场份额为9.40%,排名第二,前二位分别为汇顶科技,FPC。
3　公司主要会计数据和财务指标
31　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,173,524,466.50	2,860,830,541.44	115.79	2,574,373,457.25
营业收入	3,202,917,103.20	2,245,786,322.12	42.62	2,029,708,831.51
归属于上市公司股东的净利润	606,922,090.23	405,006,415.38	49.85	397,416,022.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,580,365.48	360,929,818.56	56.70	331,518,681.54
归属于上市公司股东的净资产	5,225,477,100.07	1,897,177,498.58	175.43	1,756,488,318.74
经营活动产生的现金流量净额	967,347,203.67	619,644,515.93	56.11	197,704,223.29
基本每股收益(元/股)	2.02	1.44	40.28	1.42
稀释每股收益(元/股)	2.01	1.43	40.56	1.41
加权平均净资产收益率(%)	16.96	22.25	减少5.29个百分点	26.27

32　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	456,337,509.24	745,720,085.85	1,001,607,890.28	999,251,617.83
归属于上市公司股东的净利润	39,675,056.35	147,811,923.35	262,201,489.64	157,233,620.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,814,618.96	127,550,404.82	235,495,545.48	170,719,796.22
经营活动产生的现金流量净额	34,269,773.35	316,355,964.19	352,863,622.23	263,857,853.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用
4　股本及股东情况
41　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

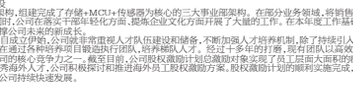
截止报告期末普通股股东总数(户)	25,321
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	40,063

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱一明	-6,391,160	32,150,000	10.01	0	无		境内自然人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	31,213,000	9.72	0	无		国有法人
InCorner Limited	-7,321,600	21,965,000	6.84	0	无		境外法人
讯安投资有限公司	-8,497,681	15,648,215	4.87	0	无		境外法人
陕西省国际信托股份有限公司-睿信-财富28号单一资金信托	0	15,081,300	4.70	0	无		国有法人
葛卫东	11,740,198	14,390,198	4.48	5,035,112	无		境内自然人
顺源(香港)有限公司	11,221,541	11,221,541	3.49	11,221,541	无		境外法人
香港中央结算有限公司	7,921,531	8,175,911	2.55	0	无		境外法人
青岛城投股权投资管理有限公司-青岛海控城投股权投资基金企业(有限合伙)	3,611,241	3,611,241	1.12	3,611,241	无		境内非国有法人
全国社保基金四零一组合	-2,699,744	3,600,272	1.12	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　朱一明与控股股东珠海芯存科技有限公司为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

42　公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图



43　公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图

44　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用　√不适用
5　公司债券情况
□适用　√不适用
三　经营情况讨论与分析
1　报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入32,01,292万元,比2018年同期增长42.62%;归属于上市公司股东的净利润60,692万元,比2018年同期增长49.85%。
1.1 优化产品线,提升竞争力
公司的现有业务包括分为存储,MCU和传感器三大方向。
2019年度,Flash市场开始复苏,一方面,随着5G的推进,NOR Flash产品,要计世物联网,可穿戴,消费类市场,推出业界最小封装15mm x 15mm USON8低功耗宽电压产品线;针对有高性能要求的应用领域推出了国内首颗符合JEDEC规范的8通道SPI产品;针对工控,汽车电子等应用领域,推出了业界性能领先的256Mb,512Mb等产品;并依据AEC-Q100标准以定了GD25全系列产品,为汽车前装市场以及需要车规级产品的客户群体定开提供高性能和高可靠性的解决方案。NAND市场,NAND闪存产品已稳定量产,具备业界领先的性能和可靠性,并持续推进24nm制程产品进程,完善中小容量NAND Flash产品系列。2019年,得益于公司Flash产品的技术创新,以及TWS耳机等驱动的Nor Flash产品需求增加,根据CINNO Research产业研究,公司NOR Flash全球市场份额在第二季度实现提升,上升至全球第四,并在第三季度跃居全球第二。
MCU产品,要计世物联网,可穿戴,消费类市场,公司发布基于Arm® Cortex®-M3内核的32位超级产品,GD32E230系列超值型微控制器,集成了片上存储器,定时器,数据转换器和众多接口外设,并提供了全新的可编程模块(CLU),提供更强的硬件灵活性,信号处理实时性,并提供更柔性封装,新增封装集成度等特性对于消如光收发器,光模块,投入网络下投系统应用非常有利。公司在2019内成功研发出全球首颗通用RISC-V MCU(GD32V产品系列),创新采用RISC-V架构嵌入式处理器内核,并为通用MCU,并向客户提供完整的软件包,并发展性,集成方案等支持,应用覆盖物联网,工业控制,智能终端等领域,GD32V全国产主产品系列将为客户提供更多选择,同时也助力公司应对未来碎片化物联网应用需求。同时,公司也正在积极推进“MCU百货商店”战略计划,陆续推出比线MCU,微控制器芯片等全新产品系列,为客户提供丰富选择。
2019年,公司积极推进与以太网,工业控制,汽车电子,人机界面,电机控制,智能家居家电及物联网等领域,以太网物理层芯片,超小封装通信模式光学指纹产品,超薄光学指纹产品,大面积TFT光学指纹产品,成为全行业唯一一家拥有指纹全覆盖品类的公司。在MEMS超声指纹传感器研发方面也取得了创新性进展。
1.2 持续加大研发投入
集成电路行业是技术密集型行业,不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动力。公司高度重视并始终保持高水平研发投入,坚持技术创新,保证公司产品的技术先进性。2019年公司研发投入达到3.76亿元,占营业收入11.8%,相比2018年同期增长64.33%。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的同时,积累了大量的知识产权专利。截止2019年末,在美国NOR Flash,NAND Flash,MCU,指纹识别等芯片关键技术领域,公司已拥有累计1,195项国内外有效的专利申请,其中2019年已提交新申请专利201项,新获得156专利授权。持续的研发投入,是公司提升技术水平和产品竞争力的有力保障。
1.3 积极布局DRAM领域
存储芯片领域中DRAM等通用型产品市场规模较大,具有举足轻重的地位。公司积极整合产业资源,布局DRAM产品领域,进一步拓展并丰富公司产品线,提升公司区域、产品等方面的竞争力。
2019年9月,公司发布非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过人民币43.24亿元,用于DRAM芯片自研及产业化项目及补充流动资金。项目开发目标为研发32nm级(19nm,17nm)工艺制程下的DRAM技术,设计和开发DDR3,LPDDR3,DDR4,LPDDR4系列DRAM芯片。此研发项目的成功实施,将实现国内存储芯片设计企业在DRAM领域的突破,也有助于公司战略机遇业务领域。2019年,公司DRAM研发项目已进入样品阶段,并与多家国际主流客户进行样品测试,并获得端到端的反馈。
公司持续推进分配12英寸晶圆存储器研发项目合作,2019年4月26日,公司与合肥长鑫存储技术有限公司签署《可转换债权投资协议》,约定公司转换债权方式对项目投资近元,并继续研究项目后续合作方案。业务方面,公司将与合肥长鑫发展优势互补,探讨在DRAM产品销售,代工,以及工程端的多种合作模式。
1.4 有序推进投资戴合
2019年5月,公司成功完成了收过户手续及相关工商变更登记完成,标志着公司收购世立微100%股权的重大资产重组项目正式完成。公司立足于自有的Flash业务和MCU业务,积极整合新加入的基于触控和指纹识别的传感器业务,推进产业整合,拓展战略布局,打造存储,控制,传感,互联,以及边缘计算的一体化解决方案高端产品线的不同需求。重组完成后,公司在“存储公司兼事业部”的基础上,在原有业务的基础上,公司成立了三个事业部,分别为:存储事业部,MCU事业部,传感事业部,以期在公司决策层,管理层,市场,产品,人员,文化等方面的深度整合,协同创造价值,实现双赢合作,同时,为应对潜在的整合风险,通过加强审计监督、业务监督和管理监督,提高经营管理水平和防范财务风险。
1.4.1 人员和组织结构整合
作为公司全资子公司,上海思立微以独立法人主体在并开展生产经营活动,经营管理团队保持相对独立和稳定,给予其较高的自主权;同时公司成立内部整合委员会,整合思立微业务为公司传感器事业部,形成以存储+MCU+传感器为核心的三大事业部架构,各业务发展理念,管理模式,以及相关业务流程,保持高效运转。公司财务,人事行政,运营,合规法务,知识产权等职能部门进行整合,达到了良好的协同以及管控效果。
1.4.2 业务模式整合
在产品研发上,丰富了公司产品线和系统解决方案,对人机交互解决方案领域进行布局,加快进入物联网,智能家居和车载电子等市场领域。在销售业务上,通过整合并共享客户渠道,支持思立微进一步拓展业务区域,提高市场占有率,在供应链方面整合,提升了晶圆厂端供货保障,在资产方面,无形资产和固定资产等纳入统一管理理念和运营体系以合作效益用。
1.4.3 文化整合
面临完成后,公司通过引入专业咨询机构以及组织企业文化研讨会等方式,梳理,提炼企业文化,在包括思立微在内的全公司范围内组织管理培训和宣讲,提升企业文化认同感,增强公司凝聚力。
1.5 产业上下游合作及供应链管理情况
2019年公司供应链进一步优化结构,加强与中芯国际,上海华力微电子,联华电子等国际一流大厂的合作范围与合作深度,同时与台积电的合作进展顺利。截至2019年年末公司晶圆采购金额,同比增长近一倍,其中2019年度内存芯片及MCU产品采购金额近3亿元,其中2019年度内2亿元,在供应链与库存管理上积累了丰富经验。公司将引进更先进的IT系统,进一步提升自动化与大数据管理能力,利用科技进行供应链与库存管理的优化,并且积极与晶圆厂,封测厂,模组厂,代理商,客户等合作方,优势互补,优化资源配置,丰富公司产品线,有利于提高公司核心竞争力和行业地位,符合公司业务发展需要。双方之间的日常关联交易是正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,双方是互利双赢的平等互惠关系,交易对公司独立性没有影响,符合公司和全体股东利益。

证券代码:603986　证券简称:兆易创新　公告编号:2020-031

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知和材料于2020年3月8日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月25日以网络视频会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
一、经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
一、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
公司拟以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),预计派发现金红利总额为121,992,829.18元,占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的20.10%;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增128,413,504股,转增后公司股本变更为449,447,265股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本321,033,761股计算,实际派发现金红利总额、转入公积转增股本数量将以2019年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
公司2019年利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、公司基本情况
1.主营业务
公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售,其中传感器业务来自于2019年公司收购上海思立微电子科技有限公司(Silead Inc.)。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520),细分行业为闪存芯片、微控制器芯片及传感器芯片设计行业。公司产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以及通信设备、工业控制、汽车电子及工业控制设备等领域。
2.主要产品及用途
公司主要产品分为闪存芯片产品、微控制器产品以及2019年新增加的传感器产品。
公司闪存芯片产品主要为NOR Flash和NAND Flash两类。
1)NOR Flash闪代码型闪存芯片,主要用来存储代码及少量数据。公司NOR Flash产品广泛应用于PC主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、人工智能、物联网、穿戴式设备、医疗电子等。
2)NAND Flash闪数据型闪存芯片,分为两大类:大容量NAND Flash主要为MLC,TLC 2D NAND或3D NAND,擦写次数从几百次至数千次,多应用于大容量数据存储;小容量NAND Flash 主要是SLC 2D NAND,可靠性更高,擦写次数达到数万次以上。公司NAND Flash产品属于SLC NAND,广泛应用于网络设备、消费电子、智能电表、工业控制、汽车电子等。
公司微控制器产品(Micro Control Unit,简称MCU)主要为基于ARM Cortex-M系列32位通用MCU产品,以及于2019年日月推出的全球首颗基于RISC-V内核的32位通用MCU产品。GD32作为中国32位通用MCU领域的主流产品,以24个系列320余款产品选择,覆盖率稳居市场前列,产品广泛应用于工业和消费类嵌入式市场,适用于工业控制、人机界面、电机控制、智能家居家电及物联网等领域。
传感器主要产品包括电容触控芯片,指纹识别芯片,广泛应用于新一代智能移动终端的传感器模组,也适用于工业自动化、车载人机界面及物联网等需要智能人机交互解决方案的领域。
(一)经营模式
集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。从经营模式来看,主要分为IDM模式(企业业务覆盖集成电路的设计、制造、封装和测试的所有环节)和Fabless模式(无晶圆生产线集成电路设计模式,即企业只进行集成电路的设计和销售,将制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成)两种。公司作为芯片设计企业,自成立以来一直采取Fabless模式,专注于集成电路设计及最终销售环节,将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。
从集成电路整体产业链来看,集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节,成品销售则是控制销售渠道,客户资源及品牌的销售服务环节,这两个环节是产业链中具有较大及主导作用,是不设计生产的知识创新的体现和创造价值的源泉。公司专注于研发设计和产品销售环节,在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。
从销售模式看,公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下,公司与客户直接签署销售合同(订单)并发货;经销模式下,公司与经销商签署经销协议,由公司给经销商发货,再由经销商向终端客户销售,在此模式下,采取买断式销售。
(二)公司所属行业及核心竞争优势的行业地位分析
1.行业发展状况
集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期,正全力追赶世界先进水平,也正处于快速发展阶段,我国集成电路产业起步较晚,与国际大型同类公司对比较大差距,大量集成电路产品仍然需要通过进口解决。根据中国半导体行业协会统计,2019年1-6月中国集成电路产业销售额为5043.9亿元,同比增长13.2%。其中,设计业销售额为2122.8亿元,同比增长18.5%;制造业销售额为1320.6亿元,同比增长13.1%;封装测试业销售额为1600.6亿元,同比增长5.5%。根据中国半导体行业协会设计分会统计,2019年我国集成电路设计行业发展良好,销售总值保持增长,预计达到30843亿元,较2018年增长19.7%。根据中国海关统计数据,2019年中国集成电路进口金额3055.5亿美元,同比下降12.1%;集成电路进口数量4451.3亿个,同比增长6.6%。2019年中国集成电路出口金额1015.8亿美元,同比增长20.1%;集成电路出口数量2187亿个,同比增长50.7%。
集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。2018年3月,十三届全国人大一次会议政府工作报告中,集成电路被列入加快制造业创新升级的五大产业首位。根据《中国制造2025》规划目标,到2020年集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,主导产品满足国内主要需求,其中,设计业销售额年均复合增长率达到20%,封装测试业销售额达到65亿元,同比增长15%。根据中国半导体行业协会设计分会统计,2019年我国集成电路设计行业发展良好,销售总值保持增长,预计达到30843亿元,较2018年增长19.7%。根据中国海关统计数据,2019年中国集成电路进口金额3055.5亿美元,同比下降12.1%;集成电路进口数量4451.3亿个,同比增长6.6%。2019年中国集成电路出口金额1015.8亿美元,同比增长20.1%;集成电路出口数量2187亿个,同比增长50.7%。
2.公司产品部分领域情况
随着集成电路行业的快速发展,应用场景的不断扩展,以及新兴技术例如人工智能、物联网和虚拟现实的出现,集成电路产品的市场需求不断扩大。全球知名研究机构IHS Markit数据显示,2020年全球半导体市场预收收入将达到4,500亿美元,市场规模同比增长2%,其中主要的细分应用领域预计将实现较大的增长。Research 对2019第三季度存产品研究报告显示,公司Not Flash市场份额预计到13.3%,超越晋扬控股排名全球第二,前二名分别为华邦电子和旺宏电子,分别比HIS Market报告,在中国Arm Cortex-M MCU市场,2018年公司销售额排名为第三位,市场占有率14%,前两位分别为意法半导体(STMicroelectronics)和恩智浦半导体(NXP),依据赛迪数据,2018年公司传感器业务(思立微)中,触控芯片全球市场份额为11.40%,排名第四;指纹芯片全球市场份额为9.40%,排名第二,前二位分别为汇顶科技,FPC。
3　公司主要会计数据和财务指标
31　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,173,524,466.50	2,860,830,541.44	115.79	2,574,373,457.25
营业收入	3,202,917,103.20	2,245,786,322.12	42.62	2,029,708,831.51
归属于上市公司股东的净利润	606,922,090.23	405,006,415.38	49.85	397,416,022.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,580,365.48	360,929,818.56	56.70	331,518,681.54
归属于上市公司股东的净资产	5,225,477,100.07	1,897,177,498.58	175.43	1,756,488,318.74
经营活动产生的现金流量净额	967,347,203.67	619,644,515.93	56.11	197,704,223.29
基本每股收益(元/股)	2.02	1.44	40.28	1.42
稀释每股收益(元/股)	2.01	1.43	40.56	1.41
加权平均净资产收益率(%)	16.96	22.25	减少5.29个百分点	26.27

32　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	456,337,509.24	745,720,085.85	1,001,607,890.28	999,251,617.83
归属于上市公司股东的净利润	39,675,056.35	147,811,923.35	262,201,489.64	157,233,620.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,814,618.96	127,550,404.82	235,495,545.48	170,719,796.22
经营活动产生的现金流量净额	34,269,773.35	316,355,964.19	352,863,622.23	263,857,853.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用
4　股本及股东情况
41　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,321
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	40,063

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱一明	-6,391,160	32,150,000	10.01	0	无		境内自然人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	31,213,000	9.72	0	无		国有法人
InCorner Limited	-7,321,600	21,965,000	6.84	0	无		境外法人
讯安投资有限公司	-8,497,681	15,648,215	4.87	0	无		境外法人
陕西省国际信托股份有限公司-睿信-财富28号单一资金信托	0	15,081,300	4.70	0	无		国有法人
葛卫东	11,740,198	14,390,198	4.48	5,035,112	无		境内自然人
顺源(香港)有限公司	11,221,541	11,221,541	3.49	11,221,541	无		境外法人
香港中央结算有限公司	7,921,531	8,175,911	2.55	0	无		境外法人
青岛城投股权投资管理有限公司-青岛海控城投股权投资基金企业(有限合伙)	3,611,241	3,611,241	1.12	3,611,241	无		境内非国有法人
全国社保基金四零一组合	-2,699,744	3,600,272	1.12	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　朱一明与控股股东珠海芯存科技有限公司为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

42　公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

43　公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图

44　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用　√不适用
5　公司债券情况
□适用　√不适用
三　经营情况讨论与分析
1　报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入32,01,292万元,比2018年同期增长42.62%;归属于上市公司股东的净利润60,692万元,比2018年同期增长49.85%。
1.1 优化产品线,提升竞争力
公司的现有业务包括分为存储,MCU和传感器三大方向。
2019年度,Flash市场开始复苏,一方面,随着5G的推进,NOR Flash产品,要计世物联网,可穿戴,消费类市场,推出业界最小封装15mm x 15mm USON8低功耗宽电压产品线;针对有高性能要求的应用领域推出了国内首颗符合JEDEC规范的8通道SPI产品;针对工控,汽车电子等应用领域,推出了业界性能领先的256Mb,512Mb等产品;并依据AEC-Q100标准以定了GD25全系列产品,为汽车前装市场以及需要车规级产品的客户群体定开提供高性能和高可靠性的解决方案。NAND市场,NAND闪存产品已稳定量产,具备业界领先的性能和可靠性,并持续推进24nm制程产品进程,完善中小容量NAND Flash产品系列。2019年,得益于公司Flash产品的技术创新,以及TWS耳机等驱动的Nor Flash产品需求增加,根据CINNO Research产业研究,公司NOR Flash全球市场份额在第二季度实现提升,上升至全球第四,并在第三季度跃居全球第二。
MCU产品,要计世物联网,可穿戴,消费类市场,公司发布基于Arm® Cortex®-M3内核的32位超级产品,GD32E230系列超值型微控制器,集成了片上存储器,定时器,数据转换器和众多接口外设,并提供了全新的可编程模块(CLU),提供更强的硬件灵活性,信号处理实时性,并提供更柔性封装,新增封装集成度等特性对于诸如光收发器,光模块,投入网络下投系统应用非常有利。公司在2019内成功研发出全球首颗通用RISC-V MCU(GD32V产品系列),创新采用RISC-V架构嵌入式处理器内核,并为通用MCU,并向客户提供完整的软件包,并发展性,集成方案等支持,应用覆盖物联网,工业控制,智能终端等领域,GD32V全国产主产品系列将为客户提供更多选择,同时也助力公司应对未来碎片化物联网应用需求。同时,公司也正在积极推进“MCU百货商店”战略计划,陆续推出比线MCU,微控制器芯片等全新产品系列,为客户提供丰富选择。
2019年,公司积极推进与以太网,工业控制,汽车电子,人机界面,电机控制,智能家居家电及物联网等领域,以太网物理层芯片,超小封装通信模式光学指纹产品,超薄光学指纹产品,大面积TFT光学指纹产品,成为全行业唯一一家拥有指纹全覆盖品类的公司。在MEMS超声指纹传感器研发方面也取得了创新性进展。
1.2 持续加大研发投入
集成电路行业是技术密集型行业,不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动力。公司高度重视并始终保持高水平研发投入,坚持技术创新,保证公司产品的技术先进性。2019年公司研发投入达到3.76亿元,占营业收入11.8%,相比2018年同期增长64.33%。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的同时,积累了大量的知识产权专利。截止2019年末,在美国NOR Flash,NAND Flash,MCU,指纹识别等芯片关键技术领域,公司已拥有累计1,195项国内外有效的专利申请,其中2019年已提交新申请专利201项,新获得156专利授权。持续的研发投入,是公司提升技术水平和产品竞争力的有力保障。
1.3 积极布局DRAM领域
存储芯片领域中DRAM等通用型产品市场规模较大,具有举足轻重的地位。公司积极整合产业资源,布局DRAM产品领域,进一步拓展并丰富公司产品线,提升公司区域、产品等方面的竞争力。
2019年9月,公司发布非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过人民币43.24亿元